

电子

周跟踪 (20230731-20230806)

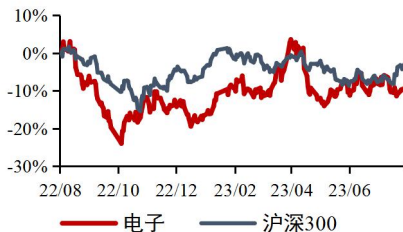
领先大市-A(维持)

——AMD 二季度营收同比下滑，手机需求疲软拖累高通、苹果业绩

2023年8月6日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：
德州仪器订单取消量仍居高位，通用电气上调 2023 年业绩指引 2023.7.30

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：
台积电下调 2023 年营收指引 2023.7.25

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体：**本周（2023.7.31-2023.8.06）市场整体上涨，上证指数涨 0.37%，深圳成指涨 1.24%，创业板指数涨 1.97%，科创 50 涨 1.36%，申万电子指数涨 1.57%，Wind 半导体指数涨 0.96%，费城半导体指数跌 3.96%，台湾半导体指数跌 2.49%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为消费电子（+3.38%）、模拟芯片设计（+3.37%）、半导体材料（+2.78%）。从个股情况看，涨幅前五为：茂莱光学（+19.99%）、海光信息（+11.71%）、宝明科技（+11.71%）、芯海科技（+10.97%）、显盈科技（+10.72%）；跌幅前五为：赛微电子（-15.24%）、佰维存储（-13.33%）、百邦科技（-13.06%）、金海通（-12.74%）、江波龙（-12.14%）。

➢ **行业新闻：**超威半导体 Q2 营收同比下滑。超威半导体发布财报显示，该公司 2023 年第二季度调整后每股收益 0.58 美元，低于预期 0.57 美元；营收 54 亿美元，高于预期 53.11 亿美元；净利润 0.27 亿美元，低于预期 0.92 亿美元。AMD 预计第三季度营收 54 亿-60 亿美元，三季度营收指引中值低于分析师预期 58.4 亿美元，但预计因需求增长推动，三季度数据中心和 PC 相关业务都将环比两位数增长。

手机需求持续疲软拖累高通业绩。高通公布 2023 财年第三财季财报，财报显示，高通第三财季营收为 84.4 亿美元，同比下降 23%，低于分析师平均预期的 85 亿美元；净利润为 18 亿美元，同比下降 52%；摊薄后每股收益 1.6 美元，同比下降 51%。其中，手机芯片业务销售额同比下降 25%，至 52.6 亿美元。

➢ **重要公告：**【艾比森】：7 月 31 日发布 2023 半年报，报告显示上半年营业收入 15.92 亿元，比上年同期增长 44.66%；归母净利润 1.43 亿元，比上年同期增长 75.45%。【盛美上海】：8 月 4 日发布 2023 半年报，报告显示上半年营业收入 16.10 亿元，比上年同期增长 46.94%；归母净利润 4.39 亿元，比去年同期增长 85.74%。【三安光电】：8 月 4 日发布 2023 半年报，报告显示上半年营业收入 64.69 亿元，同比减少 4.33%；归母净利润 1.70 亿元，同比减少 81.76%。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
1.4 大厂景气度.....	6
2. 数据跟踪.....	8
3. 新闻公告.....	13
3.1 重大事项.....	13
3.2 行业新闻.....	14
3.3 公司公告.....	14
4. 风险提示.....	16

图表目录

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2: 周涨跌幅消费电子、模拟芯片设计、半导体材料周表现领先.....	4
图 3: 月涨跌幅模拟芯片设计、集成电路封测、光学光电子月表现领先.....	5
图 4: 年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子年初至今表现领先.....	5
图 5: 多数板块当前 P/E 低于历史平均水平.....	5
图 6: 多数板块当前 P/B 处于历史平均水平.....	5
图 7: 本周个股涨幅前五.....	6
图 8: 本周个股跌幅前五.....	6

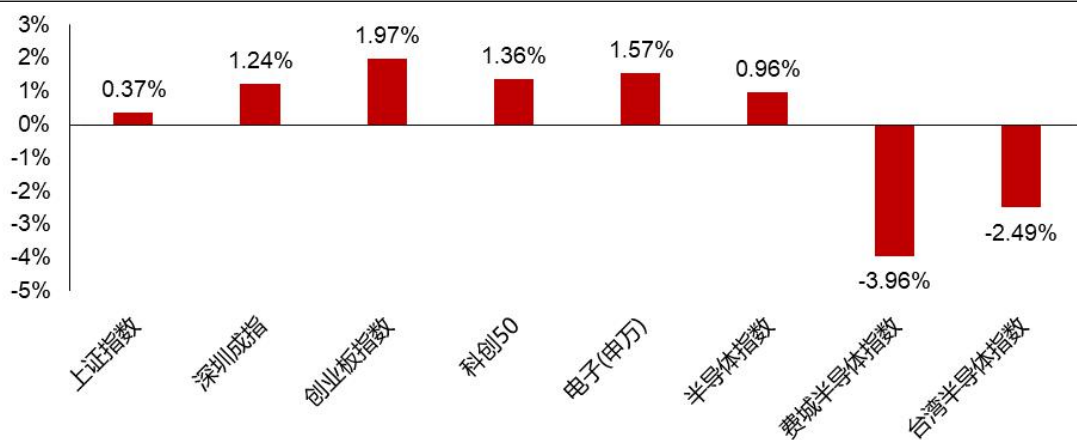
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	8
图 10: 分地区半导体销售额.....	8
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	9
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	9
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	9
图 14: 北美半导体设备销售额.....	9
图 15: 日本半导体设备销售额.....	9
图 16: 全球硅片出货面积.....	9
图 17: NAND 现货平均价.....	10
图 18: DRAM 现货均价.....	10
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	10
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	10
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	10
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	11
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	11
表 1: 大厂最新指引.....	6
表 2: 主要半导体产品货期.....	12
表 3: 主要半导体公司存货周转天数.....	12
表 4: 主要半导体公司毛利率情况.....	13
表 5: 本周重大事项.....	13
表 6: 本周重要行业新闻.....	14
表 7: 本周重要公司公告.....	14

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周(2023.7.31-2023.8.06)市场整体上涨,上证指数涨0.37%,深圳成指涨1.24%,创业板指数涨1.97%,科创50涨1.36%,申万电子指数涨1.57%,Wind半导体指数涨0.96%,费城半导体指数跌3.96%,台湾半导体指数跌2.49%。

图1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅

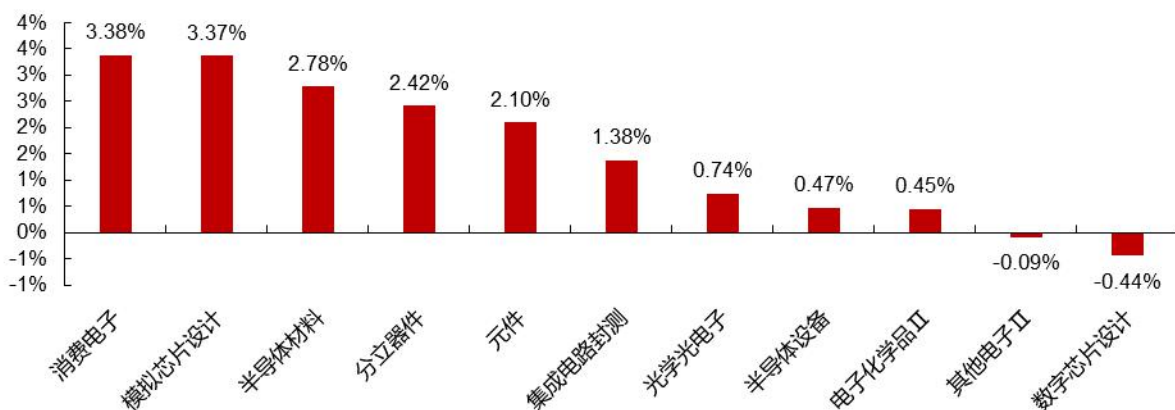


资料来源: Wind, 山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

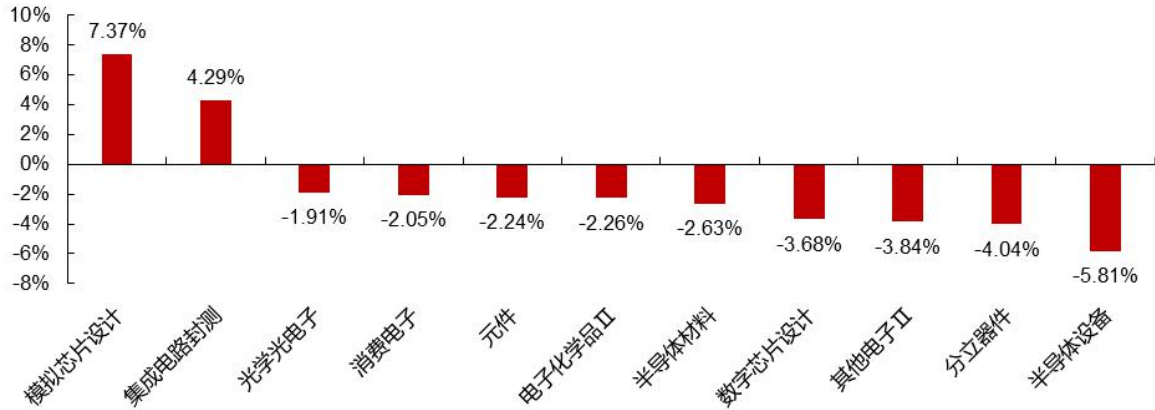
图2: 周涨跌幅消费电子、模拟芯片设计、半导体材料周表现领先



资料来源: Wind, 山西证券研究所

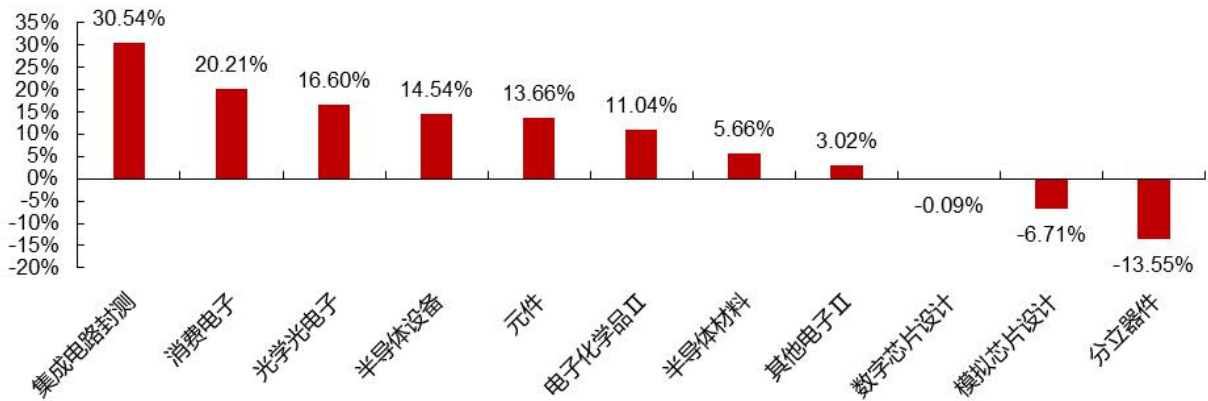


图 3：月涨跌幅模拟芯片设计、集成电路封测、光学光电子月表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

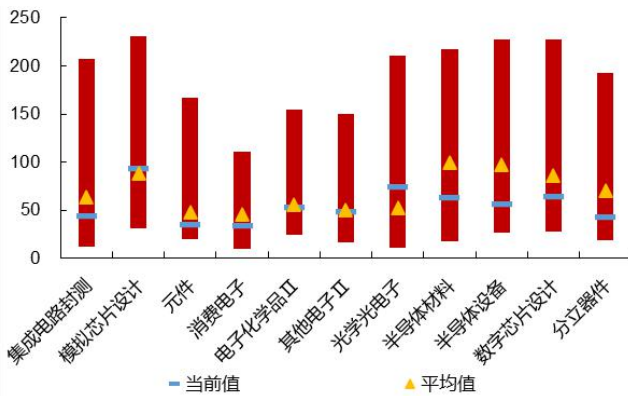
图 4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子年初至今表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

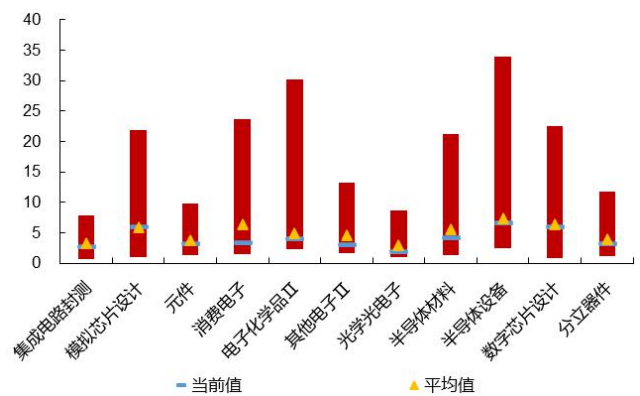
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 低于历史平均水平



资料来源：Wind 山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 处于历史平均水平

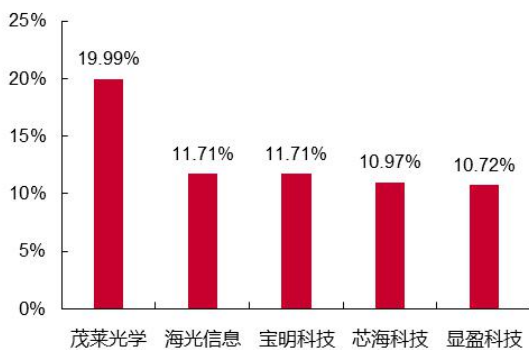


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

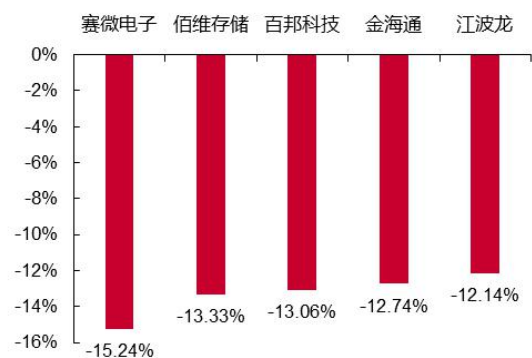
从个股情况看，茂莱光学、海光信息、宝明科技、芯海科技、显盈科技涨幅领先，涨幅分别为 19.99%、11.71%、11.71%、10.97%、10.72%。赛微电子、佰维存储、百邦科技、金海通、江波龙跌幅居前，跌幅分别为-15.24%、-13.33%、-13.06%、-12.74%、-12.14%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

1.4 大厂景气度

表 1：大厂最新指引

板块	公司	财年	时期	景气度
存储	美光	23Q3	23.3-23.6	Q2 业绩符合预期，AI 存储需求高于预期，HBM 客户反应强烈，预计 24 年初量产。DDR5 出货量翻倍，预计 24Q1 销量超过 D4。数据中心 SSD 开始采用 176 层或 232 层 NAND，Q3 推出全球首款 200+层 NAND 数据中心 SSD。PC 销量下滑，预计客户在 2024 年初上量 D5。预计客户库存在 Q3 恢复正常，TAM 需求提升。智能手机销量下滑，单高端机型的内存需求强劲。汽车销量提升，23H2 受益客户库存正常及内容容量增加。工业复苏迹象初显，23H2 需求改善。23 年 DRAM 预期增长 1%-5%，NAND 预期增长 6%-9%。本财季 DRAM 价格环比下滑 10%，NAND 下滑 14%-19%。23 年资本开支为 70 亿美元，同比下滑 40%。DRAM 和 NAND 的晶圆开工率降低至 30%，将持续至 2024 年。
	海力士	23Q1	23.1-23.3	23Q1 净亏环比收窄，DRAM ASP 环比下滑 15%-19%，NAND ASP 环比下滑 10%。游戏 PC 销量增加带动存储需求，旗舰机对高性能产品需求增加，AI 发展对 HBM 需求提升。预计 23 年 DRAM 收入增长 4%-9%，NAND 收入增长 14%-19%，23 年资本开支同比下降 50%，预计下半年市场环境有所改善。
MCU	NXP	23Q1	23.1-23.3	23Q1 营收高于指引中值，毛利率为 58.2%，高于指引中值。汽车业务环比增长 1%，同比增长 17%；工业领域环比下滑 17%，同比下滑 26%；手机领域环比下滑 36%，同比下滑 35%；通信业务同比增加 7%，环比增加 7%。23Q2 营收指引中值 32 亿美元，2021-2024 年，预计营收 CAGR 为 8%-12%，汽车业务 CAGR 为 9%-14%，工业领域 CAGR 为 9-14%，手机业务 CAGR 为 8%-10%，通信领域 CAGR 为 2%-6%，资本开支



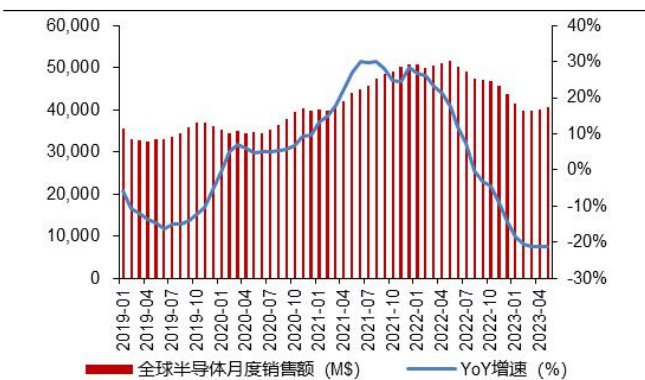
				CAGR 为 6%-8%。
	ST	23Q2	23.4-23.6	2023Q2 意法半导体第二季度营收同比增长 12.7% 至 43.26 亿美元, 超出市场预期的 42.9 亿美元; 净利润为 10 亿美元, 同比增长 15.5%; eps 为 1.06 美元, 同比增长 15.2%。意法半导体首席执行官 Jean-Marc Chery 表示, “营收表现继续受到汽车和工业业务增长的推动, 部分被个人电子业务营收下滑所抵消。” 意法半导体预计第三季度净营收为 43.8 亿美元, 毛利率 47.5%。全年营收预期收窄至 172.5 亿美元至 175.5 亿美元之间, 此前的预测是在 170 亿美元至 178 亿美元之间。
	微芯	23 年	22.4-23.3	23 年强劲客户需求超过预期, 持续增加资本开支用于扩产。2021-2026 年, 营收 CAGR 为 10%-15%
模拟 IC	TI	23Q2	23.4-23.6	2023Q2 营收 45.3 亿美元, 同比下降 13.1%, 超出市场预期的 43.7 亿美元; 利润为 19.7 亿美元, 同比下降 28%; 净利润为 17.2 亿美元, 同比下降 25%; 每股收益为 1.87 美元, 同比下降 23.7%, 仍好于市场预期的 1.77 美元。指引方面, 公司预计 Q3 营收将在 43.6 亿美元至 47.4 亿美元之间, 这一区间的中间值将低于分析师平均预期的 45.9 亿美元; 每股收益 1.68 至 1.92 美元, 中值低于市场普遍预期为 1.9 美元。公司 CEO 表示, 汽车芯片业务是最近一季的亮点, 但其他业务低迷; 库存将帮助公司度过未来需求激增的时期。此外, 目前取消订单的数量仍处于较高水平, 这表明客户仍保持谨慎。
	ADI	23Q2	23.2-23.4	本季度营收高于指引中值, 营收同比增加 10%, 工业领域同比增长 16%, 汽车同比增长 24%。23Q3 财季收入中值约为 31 亿美元, 工业和汽车开始疲软, 预计环比下降低个位数到中个位数, 通信市场环比下降 10%, 消费市场环比增长。
射频 IC	Qorvo	24Q1	23.5-23.7	按公认会计准则计算, Qorvo 2024 财年第一季度的收入为 6.51 亿美元, 毛利率为 35.2%; 营业亏损为 4800 万美元, 每股亏损为 0.44 美元。Qorvo 在收入、毛利率和每股收益方面超过 6 月份季度指引的中点, 同时还在继续减少渠道库存。公司预计 2024 财年收入将同比增长。
	博通	23Q2	23.2-23.4	23Q2 营收同比增加 8%, 公司持续布局 AI 领域, 相关收入增长有望超过 20%。23Q3 财季营收指引为 88.5 亿美元, 同比增加约为 5%。
AI 芯片	英伟达	24Q1	23.1-23.3	24Q1 总收入下滑 13%, 达到 71.9 亿美元, 仍高于预期的 65 亿美元。数据中心同比增长 14%, 环比增加 18%; 游戏同比下滑 38%, 环比提升 22%; 汽车业务同比增加 114%, 环比增加 1%。AI 和大模型需求提升, 公司 24Q2 营收指引 110 亿美元。24Q2 财季资本开支 3-3.5 亿美元, 24 财年资本开支 11-13 亿美元。
	AMD	23Q2	23.4-23.6	Q2 调整后每股收益 0.58 美元, 低于预期 0.57 美元; 营收 54 亿美元, 略高于预期 53.11 亿美元; 净利润 0.27 亿美元, 低于预期 0.92 亿美元。AMD 预计第三季度营收 54 亿-60 亿美元, 三季度营收指引中值低于分析师预期 58.4 亿美元, 但预计因需求增长推动, 三季度数据中心和 PC 相关业务都将环比两位数增长。
功率半导体	英飞凌	23Q2	23.1-23.3	Q2 业绩超预期, AVT 和 GIP 业务亮眼。23Q3 营收指引 40 亿欧元, ATV 部门增速高于 Q2, GIP 部门营收持平, PSS 和 CSS 部门收入下降。23 年全年营收指引 162 亿欧元, 同比增加 14%, 资本开支指引 30 亿欧元。
	安森美	23Q1	23.1-23.3	Q1 业绩高于预期中值, 汽车与工业驱动业绩增长。2021-2025 年, 电源业务 CAGR 为 6%, 传感器 CAGR 为 10%, 汽车业务增速为 17%, 工业领域增速为 7%。23Q2 营收指引 19.75-20.75 亿美元, 毛利率指引 45.5%-47.5%, 环比下降 0.34 pct, 资本开支规划 4.2 亿-4.6 亿美元。
晶圆	台积电	23Q2	23.4-23.6	Q2 营收好于预期, 环比下滑 6.2%, 同比下滑 13.7%, 毛利率为 54.1%, 环比下滑 2.2pct。

代工 厂				消费电子环比增加+25%，汽车电子环比增加+3%。AI 需求强劲，目前贡献公司 6% 营收，未来 5 年 CAGR 达 50%。Q3 营收指引为 167 亿-175 亿美元，毛利率为 51.5%-53.5%。 预计 23 年营收同比下滑 10%，资本开支为 320 亿-360 亿美元。
	联电	23Q2	23.4-23.6	2023Q2 营收为新台币 563 亿元，较上季的 542.1 亿元增加 3.8%；与 2022 年第二季的 720.6 亿元相比则减少了 21.9%。本季毛利率为 36.0%，归属母公司净利为新台币 156.4 亿元，每股普通股获利为新台币 1.27 元，与先前预测相符。营收的增加主要受惠于 12 寸产品组合的优化。来自 22/28nm 产品的营收持续增加，占本季营收的 29%；从应用类别角度，WiFi、数位电视和显示器驱动 IC 等消费领域的需求出现短期回温。王石总经理表示：“展望第三季，由于供应链库存持续调整，晶圆需求前景尚不明确。整体终端市场的气氛仍然疲弱，预期客户在近期内还是会维持严谨的库存管理。”
设备	应用材料	23Q2	23.2-23.4	Q2 营收超预期，同比增加 6%，环比减少 2%。23Q3 营收指引 61.5 亿美元，半导体系统营收 45 亿，AGS 营收 14.3 亿。
	泛林半导体	23Q1	23.1-23.3	Q1 营收 38.7 亿美元，高于预期中值，Q2 营收指引 31 亿美元，毛利率指引 2.2%-44.2%。 23 年 WFE 行业指引 750 亿美元，内存预计同比下降 50%。
	东京电子	23 年	22.4-23.3	SPE 实现营收 122.4 亿美元，同比增加 10.9%。23 年半导体市场同比下滑 10%，2024 年将超过 2022 年水平。预计 2023 年下半年逻辑/晶圆代工开始复苏，行业收入全年 700-750 亿美元。预计 2024 年半导体行业和 WFE 复苏实现进一步增长。公司 24 财年营收指引为 123 亿美元，同比下滑 23%。24 财年资本开支规划 8.8 亿美元。
	AMSL	23Q1	23.1-23.3	Q1 收入超预期，YoY+90.9%，QoQ+4.9%。23Q2 营收指引 65-70 亿欧元，毛利率指引 50%-51%，23 年营收指引同比增长 25%。2025 年营收指引 300-400 亿欧元，2030 年指引 440-600 亿欧元。
传感器	通用电气	23Q2	23.4-23.6	2023Q2 营收为 159 亿美元，同比增长 19%，好于市场预期；调整后每股收益为 0.68 美元，好于市场预期，上年同期为 0.36 美元；订单总额为 220 亿美元，同比增长 59%。展望未来，通用电气上调了 2023 年业绩指引，目前该公司预计内生性营收增速为低两位数，此前预期为高个位数；调整后每股收益为 2.10 美元至 2.30 美元，好于市场预期的 2.05 美元，此前预期为 1.70 美元至 2.00 美元。

资料来源：各公司官网，山西证券研究所

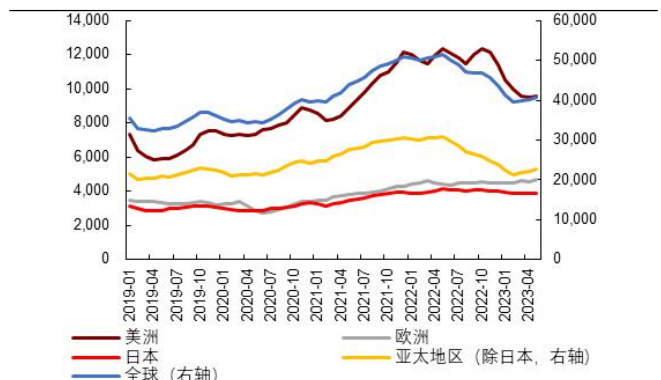
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



资料来源：WSTS，山西证券研究所

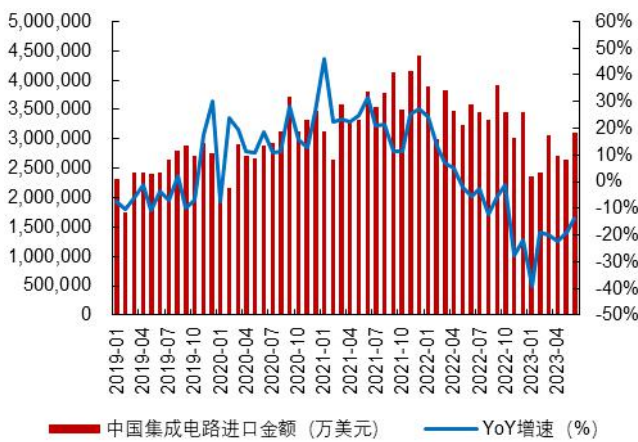
图 10：分地区半导体销售额



资料来源：WSTS，山西证券研究所

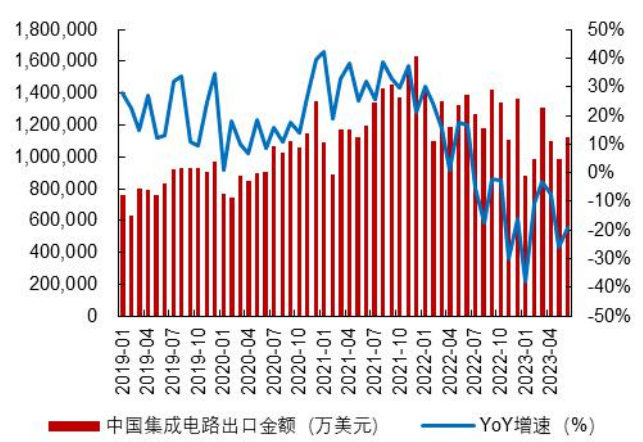


图 11：中国集成电路行业进口情况



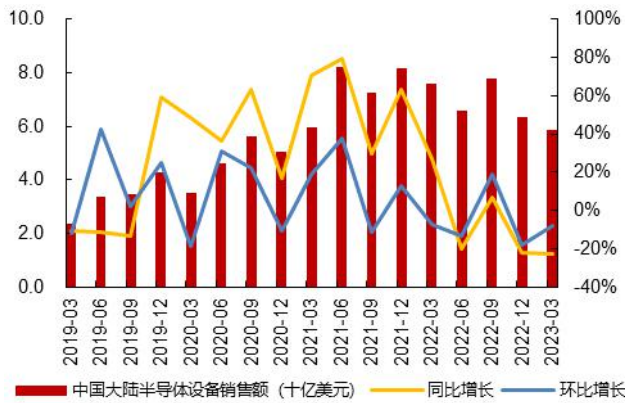
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



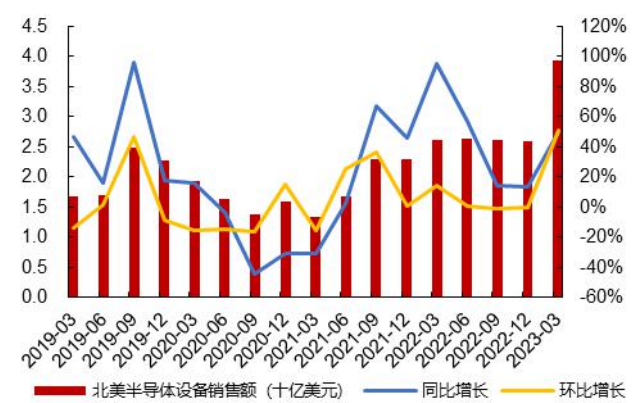
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



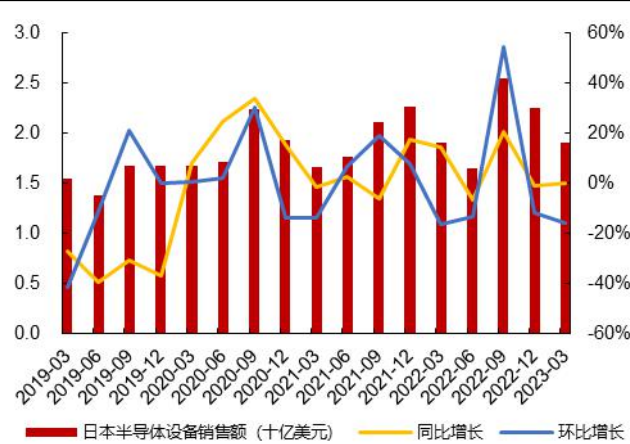
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



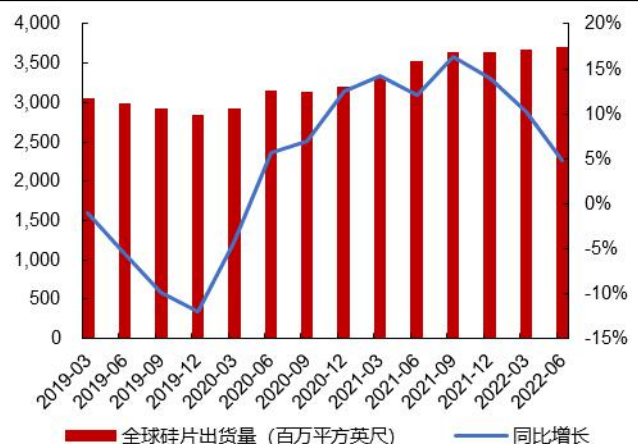
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



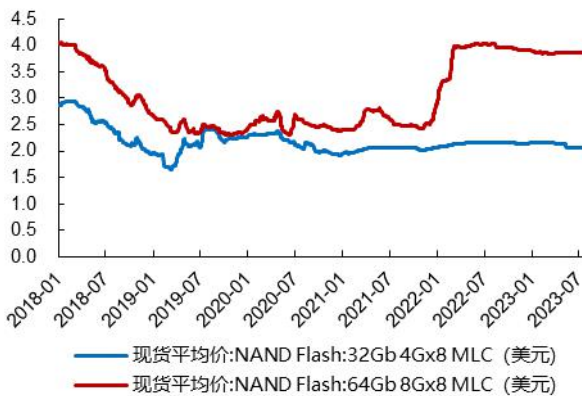
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



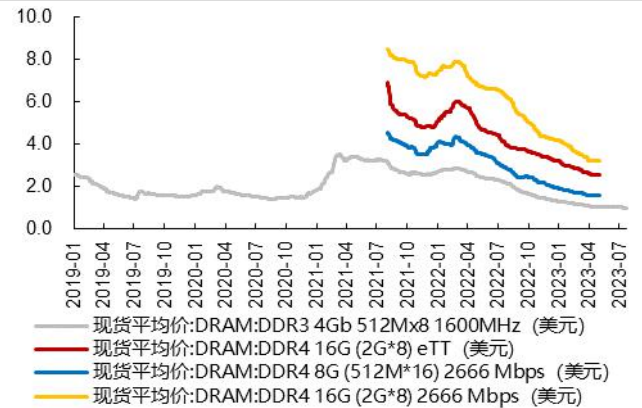
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 17: NAND 现货均价



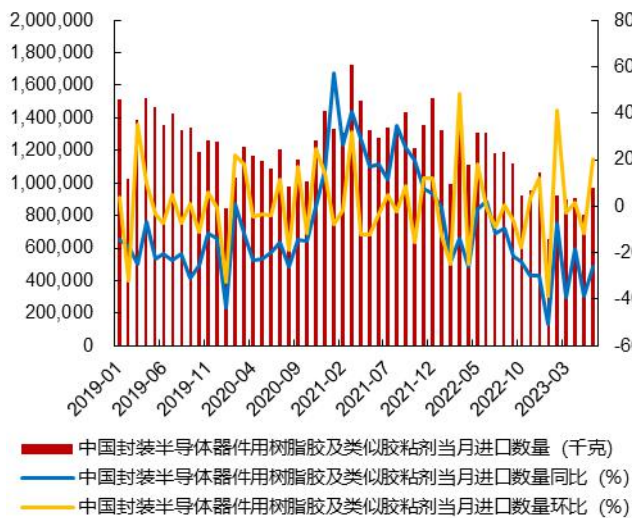
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



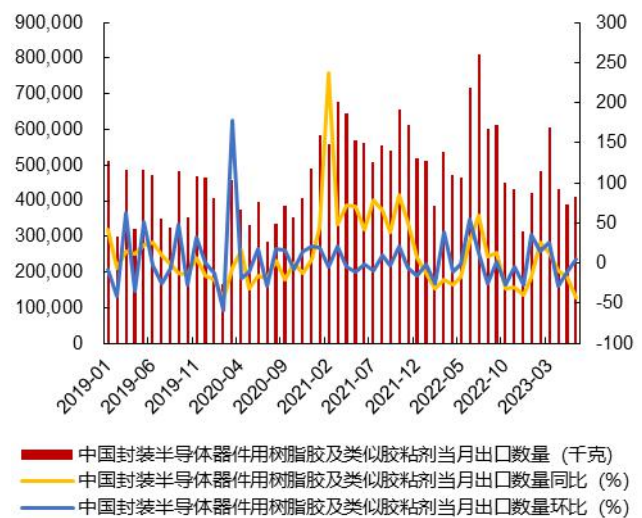
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



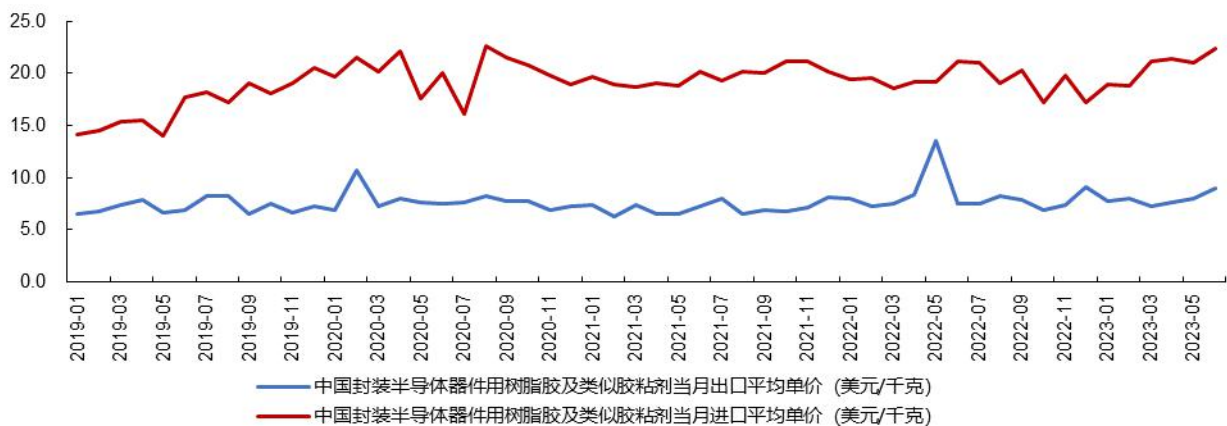
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



资料来源: Wind, 山西证券研究所

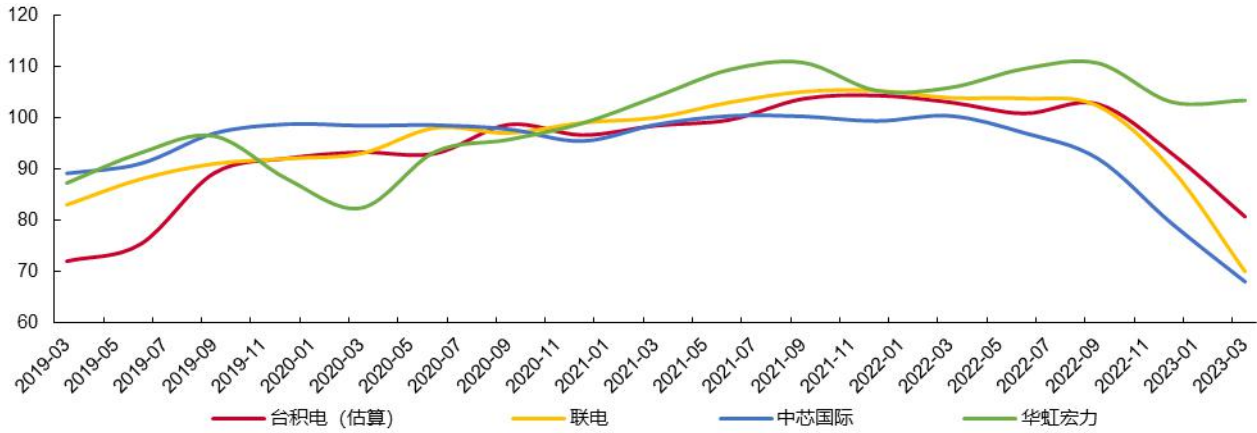
图 21: 半导体封装材料进出口均价



资料来源: Wind, 山西证券研究所

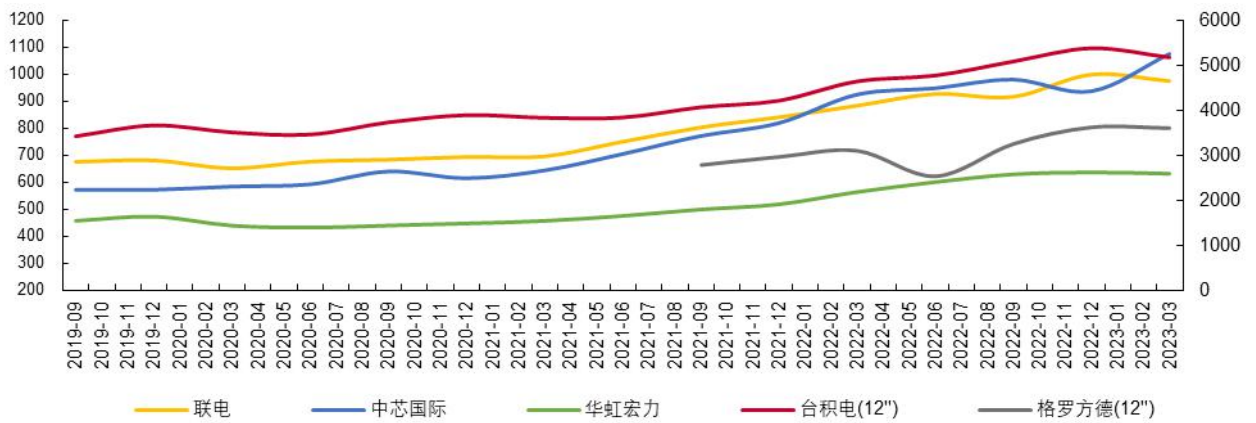


图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：Wind，山西证券研究所

表 2：主要半导体产品货期

低压 MOSFET 货期 (周)				高压 MOSFET 货期 (周)				IGBT 货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
Infineon	20-52	↘	↔	Infineon	50-54	↔	↔	Fairchild	39-52	↔	↔
Diodes	26-54	↘	↔	On Semi	36-52	↔	↗	Infineon	39-50	↔	↔
On Semi	36-52	↘	↗	IXYS	50-54	↔	↔	STMicro	47-52	↔	↔
Nexperia	47-52	↔	↔	STMicro	47-52	↔	↔				
8 位 MCU 货期 (周)				32 位 MCU 货期 (周)				FPGA 货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
NXP	35-52	↘	↔	NXP	26-52	↘	↔	Lattice	28-42	↘	↔
Microchip	36-52+	↘	↔	Microchip	36-52+	↘	↔	Microsemi	32-42	↘	↔
Renesas	18-24	↘	↔	Renesas	18-24	↘	↔				
传感器货期 (周)				信号链 (放大器和数据转换器) 货期 (周)				NAND 闪存货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
Melexis	35-40	↘	↗	On Semi	26-42	↘	↔	Macronix	8-12	↔	SMA
NXP	16-52	↗	↗	Renesas	36-40	↔	↔	Alliance Memory	8-24	↘	↔
Infineon	18-52	↔	↗								

资料来源：富昌电子，山西证券研究所

表 3：主要半导体公司存货周转天数

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Infineon	143		斯达半导	150	
On Semi	148		士兰微	189	
			华润微	115	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
TI	179		圣邦股份	286	
ADI	128		思瑞浦	219	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Micron	167		北京君正	311	
Samsung	104		兆易创新	238	
			澜起科技	358	
海外 MCU 芯片公司			国内 MCU 芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
NXP	125		北京君正	311	
Microchip	157		兆易创新	238	
Renesas	106		中微半导	487	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
北方华创	570		风华高科	72	
芯源微	773		三环集团	231	
长川科技	1070		法拉电子	112	
中微公司	492		泰晶科技	114	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
三安光电	218		歌尔股份	60	
乾照光电	104		工业富联	70	
聚灿光电	51		立讯精密	67	
京东方 A	60				

资料来源：Wind，山西证券研究所

表 4：主要半导体公司毛利率情况

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Infineon	46.90%		斯达半导	36.43%	
On Semi	46.82%		士兰微	26.17%	
			华润微	34.80%	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
TI	65.38%		圣邦股份	52.66%	
ADI	65.72%		思瑞浦	57.85%	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Micron	-17.80%		北京君正	37.08%	
Samsung	27.83%		兆易创新	38.25%	
			澜起科技	53.29%	
海外MCU芯片公司			国内MCU芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
NXP	56.71%		北京君正	37.08%	
Microchip	68.05%		兆易创新	38.25%	
Renesas	55.68%		中微半导	21.86%	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
北方华创	41.18%		风华高科	11.08%	
芯源微	45.31%		三环集团	39.41%	
长川科技	56.00%		法拉电子	37.65%	
中微公司	45.87%		泰晶科技	23.64%	
			台湾晶技	34.80%	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
三安光电	16.87%		歌尔股份	6.98%	
乾照光电	4.38%		工业富联	7.36%	
聚灿光电	8.61%		立讯精密	10.03%	
京东方A	6.84%				

资料来源：Wind，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 5：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2023 年 7 月 31 日		瑜欣电子；力鼎光电；福立旺；精研科技	云里物里；闻泰科技		
2023 年 8 月 1 日		力合微	扬杰科技		
2023 年 8 月 2 日	三安光电	美格智能			
2023 年 8 月 3 日	联创光电	福光股份；普冉股份			

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2023年8月4日		华体科技；思特威；超华科技；华铭智能	华铭智能；力鼎光电		
2023年8月5日					
2023年8月6日					

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 6：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2023年8月1日	上海微电子在 28nm 浸没式光刻机的研发取得重大突破，预计在 2023 年年底交付国产第一台 SSA/800-10W 光刻机设备。	快科技
2023年8月2日	为应对汽车等行业对芯片的需求，博世已在马来西亚槟城开设一个新的芯片和传感器测试中心，投资约 6500 万欧元。	全球半导体观察
2023年8月2日	超威半导体发布财报显示，该公司 2023 年第二季度调整后每股收益 0.58 美元，预期 0.57 美元；营收 54 亿美元，预期 53.11 亿美元；净利润 0.27 亿美元，预期 0.92 亿美元。AMD 预计第三季度营收 54 亿-60 亿美元，三季度营收指引中值低于分析师预期 58.4 亿美元，但预计因需求增长推动，三季度数据中心和 PC 相关业务都将环比两位数增长。	Wind
2023年8月3日	高通公布了截至 6 月 25 日的 2023 财年第三财季财报。财报显示，高通第三财季营收为 84.4 亿美元，同比下降 23%，低于分析师平均预期的 85 亿美元；净利润为 18 亿美元，同比下降 52%；摊薄后每股收益 1.6 美元，同比下降 51%。其中，高通手机芯片业务销售额同比下降 25%，至 52.6 亿美元。	Wind
2023年8月4日	苹果发布了 2023 财年三季报，财报显示，二季度苹果实现营收 817.97 亿美元，同比下降 1.40%；净利润为 198.81 亿美元，同比增长 2.26%。其中，苹果 iPhone 业务实现营收 396.69 亿美元，同比下降 2.45%。苹果营收和利润都高于市场预期，但 iPhone 收入不及预期，而且是自 2016 年以来首次连续三个季度收入同比下滑。	Wind

资料来源：快科技，全球半导体观察，Wind，山西证券研究所

3.3 公司公告

表 7：本周重要公司公告

公司	时间	公告类型	公告摘要
利亚德	7月31日	业绩预告	预计 2023 半年度归母净利润盈利:32,101.56 万元 - 36,114.25 万元，比上年同期增长 20% - 35%。
普冉股份	7月31日	业绩预告	预计 2023 年半年度实现营业收入为 40,400.00 万元到 52,300.00 万元，同比下降 8.15%到 29.05%;归母净利润为-8,700.00 万元到-6,800.00 万元，同比下降 165.77%到 184.14%。
艾比森	7月31日	中报	半年报公布。营业收入 1,591,837,956.21 元，同比+44.66%；归母净利润 142,854,624.75，

公司	时间	公告类型	公告摘要
			同比+75.45%。
江丰电子	7月31日	投资	全资子公司香港江丰在韩国投资设立 KFAM CO., LTD., 建设韩国生产基地, 本次投资总额不超过人民币 3.5 亿元。
佰维存储	8月1日	业绩预告	预计 2023 年半年度实现营业收入为 110,000 万元到 120,000 万元, 同比下降 20.54%到 13.31%;归母净利润为-28,000 万元到-32,000 万元, 同比下降 665.35%到 746.19%。
超华科技	8月1日	中报	半年报公布。营业收入 635,273,545.54 元, 同比-40.44%; 归母净利润 9,227,557.81 元, 同比-70.41%。
鼎通科技	8月1日	投资	拟以 5,000 万元人民币投资设立 1 家全资子公司鼎通科技(长沙)有限公司。投资目的: 深化公司业务合作, 进一步拓展公司主营业务, 增强综合竞争力。
恒玄科技	8月1日	股权激励	拟向激励对象授予限制性股票数量不超过 232.9060 万股, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12003.4708 万股的 1.94%。
昀冢科技	8月2日	中报	半年报公布。营业收入 242,121,513.08 元, 同比减少 5.12%; 归母净利润-48,807,012.43 元, 同比减少 445.88%。
灿瑞科技	8月2日	中报	半年报公布。营业收入 191,435,316.93 元, 同比减少 40.42%; 归母净利润-8,343,409.50 元, 同比减少 109.95%。
钜泉科技	8月2日	中报	半年报公布。营业收入 306,076,181.51 元, 同比增加 1.49%; 归母净利润 80,309,482.42 元, 同比减少 7.92%。
南亚新材	8月2日	中报	半年报公布。营业收入 1,473,617,185.37 元, 同比减少 21.50%; 归母净利润-36,615,805.75 元, 同比减少 144.17%。
芯原股份	8月2日	中报	半年报公布。营业收入 1,183,755,403.12 元, 同比减少 2.37%; 归母净利润 22,217,550.22 元, 同比增加 49.89%。
赛微电子	8月2日	投资	全资子公司赛莱克斯国际拟与深重投集团关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶共同出资设立赛莱克斯深圳, 其中公司全资子公司赛莱克斯国际出资 45,000 万元, 持有其 30%股权。
贤丰控股	8月2日	投资	拟与成大生物对史纪生物进行增资, 设立研发子公司纪康生物科技有限公司, 总增资额 6,000 万元(按持股比例公司增资 4,200 万元, 成大生物增资 1,800 万元), 增资目的: 支持动物疫苗业务的发展, 增强控股子公司的研发实力。
华体科技	8月3日	业绩快报	发布半年度业绩快报。营业总收入 317,549,121.76 元, 同比增长 53.21%; 归母净利润 23,305,096.67 元, 去年同期-16,394,540.97 元。
广信材料	8月3日	股权激励	拟授予激励对象的限制性股票数量为 150.00 万股, 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 19,302.7584 万股的 0.78%。
盛美上海	8月4日	中报	半年度报告公布。营业收入 1,609,805,866.85 元, 同比增加 46.94%; 归母净利润 439,444,219.54 元, 同比增加 85.74%。
萤石网络	8月4日	中报	半年度报告公布。营业收入 2,284,694,365.69 元, 同比增加 9.25%; 归母净利润 258,546,815.71 元, 同比增加 70.30%。
三安光电	8月4日	中报	半年度报告公布。营业收入 6,469,493,227.02 元, 同比减少 4.33%; 归母净利润 169,950,686.44 元, 同比减少 81.76%。
洁美科技	8月4日	投资	投资设立全资子公司浙江洁美贸易有限公司, 公司以自有资金出资人民币 10,000 万元, 占注册资本的 100%。设立原因: 战略规划和业务发展需要。

公司	时间	公告类型	公告摘要
富创精密	8月4日	投资	拟投资 设立境外全资子公司，总投资额为 4,400 万美金。拟定子公司名称：FabSmart Precision,Inc.。投资目的：增加业务辐射范围，与现有产品产生协同效应，提高市场竞争优势。
奥拓电子	8月4日	股权激励	拟向激励对象授予 600 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 651,544,156 股的 0.92%。

资料来源：Wind，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

